

1. 개정이유 및 주요내용

기업의 연구개발 촉진 및 투자 활성화를 위해 「관세법」에 따라 관세를 감면할 수 있는 산업기술 연구·개발용 물품에 고속기류건조기, 복합사이클부식시험기, 소규모 생물배양기 등을 추가하고, 종전의 감면 대상이었던 냉각기, 포집기, 이온밀링기 등은 제외하여 총 46개 품목에 대해 관세를 감면하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합의 : 과학기술정보통신부 등과 합의되었음

라. 기타 :

관세법 시행규칙 일부개정령안

관세법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 1의2를 별지와 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(관세가 감면되는 산업기술 연구·개발용 물품에 관한 경과조치)

이 규칙 시행 전에 수입신고한 물품에 대해서는 별표 1의2의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

[별표 1의2]

법 제90조제1항제4호에 따라 관세가 감면되는 산업기술 연구·개발용 물품
(제37조제4항제1호 관련)

연번	관세율표 번호		품명	규격
	호	소호		
1	3902	90	기타	레진 아톤(Resine Arton)으로서 최대 인장강도는 71메가파스칼(MPa), 인장탄성율은 2,450메가파스칼(MPa)이고 성형수축률이 0.6%인 것으로 한정한다.
2	3908	90	기타	폴리아미드로서 휘발성 유기가스 포집용 흡착제로 사용되며 177 마이크로미터(μm) 이상 250마이크로미터(μm) 이하 사이즈의 분말 형태의 폴리머 물질인 것으로 한정한다.
3	8419	39	기타	고속 기류 건조기(Flash Jet Dryer)로서 벤추리 타입(Venturi type) 건조 분산기 내에서 고온의 제트기류로 촉매레이크의 수분을 건조시키고, 동시에 입자간 충돌과 입자와 설비의 충돌로 뭉쳐있는 분말입자를 해쇄시켜 분산하는 기능을 모두 갖추고 있는 것으로 한정한다.
4	8419	89	기타	복합사이클부식시험기(Combined Cyclic Corrosion Tester)로서 건조, 습윤, 염수, 온도, 이산화탄소 농도, 광조사 또는 결로 중 두 가지 이상의 시험 조건을 설정할 수 있는 것으로 한정한다.
5	8419	89	기타	냉각기(Cooling plant and machinery)로서 양자컴퓨터용 소자를 영하 273도($^{\circ}\text{C}$) 이하로 냉각·냉동 또는 액화할 수 있는 것으로 한정한다.
6	8419	89	기타	열충격시험기(Temperature Shock Test Chamber), HALT(Highly Accelerated Life Test Chamber)로서 최고 온도 영상 100도($^{\circ}\text{C}$) 이상, 최저 온도 영하 40도($^{\circ}\text{C}$) 이하의 환경에서 평판디스플레이, 인쇄회로기판, 반도체소자 또는 반도체모듈의 성능을 시험할 수 있는 것으로 한정한다.

7	8419	89	기타	<p>항온항습기(항온기, 항습기 및 항습배양기를 포함한다)로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 온도의 허용 오차 범위가 ± 3.0도($^{\circ}\text{C}$) 이하이거나 습도의 허용 오차 범위가 ± 5퍼센트(%) 이하인 것 2. 사용 온도가 영상 100도($^{\circ}\text{C}$) 이상이거나 영하 40도($^{\circ}\text{C}$) 이하인 것 3. 70분 내에 영하 40도($^{\circ}\text{C}$)에서 영상 150도($^{\circ}\text{C}$)까지 온도를 상승시킬 수 있는 것 4. 온도, 습도, 시간, 조명도(照明度) 또는 사이클(cycle)을 조정할 수 있는 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 <ul style="list-style-type: none"> 가. 열 스트레스(stress)를 가함으로써 시료의 열 내구성을 측정할 수 있는 것 나. 계측기와 연결하여 주파수를 측정할 수 있는 것
8	8419 8419	89 90	기타 부분품	<p>소규모 생물배양기로서 베셀(Vessel) 당 10밀리리터(mL) 이상 15밀리리터(mL) 이하를 처리할 수 있고, 20($^{\circ}\text{C}$) 이상 40도($^{\circ}\text{C}$) 이하의 환경을 구동할 수 있는 온도 조절 기능을 갖추고 있는 것으로 한정한다.</p>
9	8421	29	기타	<p>수직 유량 여과 장치로서 2밀리리터(mL) 이상 16리터(L) 이하의 표본을 정제, 농축, 투석 또는 분리할 수 있는 것으로 한정한다.</p>
10	8422 8479	40 89	그밖의 포장기계 (열수축 포장기계를 포함한다) 기타	<p>진공 라미네이터(Vacuum Laminator)로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 판넬 사이즈(Panel Size)가 3인치 이상 26인치 이하인 것 2. 정확도의 허용 오차범위가 ± 20마이크로미터(μm) 이하인 것 3. 동시에 진공, 가압, 가열하여 패키지 기판을 성형할 수 있는 것
11	8424	89	기타	<p>현상·박리기(Developer Stripper Machine)로서 한 개의 설비 내에서 현상과 박리 기능이 가능한 것으로 한정한다.</p>
12	8443	19	기타	<p>스크린 인쇄기로서 가로 길이 450밀리미터(mm) 이상이고 세로 길이 450밀리미터(mm) 이상인 스크린을 사용할 수 있고, 비전 조정카메라(vision align camera)를 이용하여 정밀하게 패턴을 인쇄할 수 있는 것으로 한정한다.</p>
13	8456	11	레이저 방식으로 하는 것	<p>레이저발진기로서 레이저의 파장이 1,340나노미터(nm)이하인 것으로 한정한다.</p>

14	8456	90	기타	이온밀링기, 이온밀링장치(Ion Milling System, Ion Beam System)로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 이온빔(Ion Beam) 또는 전자빔(Electron Beam)을 이용하여 반도체웨이퍼 또는 시편(試片)을 가공할 수 있는 것 2. 가속전압이 40킬로볼트(kV) 이하인 아르곤(Ar) 또는 갈륨(Ga) 이온 총(Ion Gun)을 장착한 것
15	8457	10	머시닝센터(Machining Centre)	머시닝센터로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 머시닝, 선삭(旋削) 및 연삭(研削) 기능을 모두 융합한 복합가공기능이 있는 것 2. 수치 제어 방식으로 동시에 3축 이상을 제어할 수 있는 것 3. 원 척킹(One Chucking)으로 다면·곡면 가공이 가능한 것
16	8460	24	기타(수치제어식으로 한정한다)	수치제어방식의 연삭기(Grinding Machine) 또는 샤프닝 머신(Sharpening Machine)으로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 기어 호브 커터(Gear Hob Cutter) 또는 브로치 커터(Broach Cutter)의 프로파일(Profile)이나 날 연삭이 가능한 것 2. 드릴(Drill), 엔드밀(End Mill) 또는 인서트(Insert)의 홈, 여유면, 날끝 각(Point) 또는 스플릿 포인트(Split Point)를 가공하는 전용 연삭기로서, 가공 지름이 0.05밀리미터(mm) 이상 80밀리미터(mm) 이하인 것
	8460	29	기타	
	8460	31	수치제어식	
	8460	39	기타	
17	8460	40	호닝머신(honing machine)이나 래핑머신(lapping machine)	연마기로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 수분을 포함한 습식 연마재를 사용하여 곡면과 요철 부위를 연마할 수 있고 원심력에 의한 사출방식인 것 2. 서보모터로 작동하는 상하구동식 연마기로서 내부지름이 12밀리미터(mm)이상 50밀리미터(mm) 이하인 물체를 연마할 수 있는 것
	8460	90	기타	
18	8477	51	공기를 넣는 타이어 성형기나 재생기와 그 밖의 이너튜브(inner tube) 성형기	자동 버핑 머신(Auto Buffing Machine)으로서 타이어 트레드의 깊이에 따라 모터를 자동으로 제어하여 트레드 표면을 마모시킬 수 있는 것으로 한정한다.
19	8479	82	혼합기·반죽기·과쇄기·분쇄기·기계식 체·시프팅기(sifting machine)·균질기·유회기·교반기	비즈(Beads) 분쇄기로서 0.03밀리미터(mm) 이상 0.5밀리미터(mm) 이하의 비즈를 투입하여 세라믹 파우더로 분쇄하고 칼날의 회전속도가 5m/s 이상 15m/s 이하인 것으로 한정한다.

20	8479	89	기타	전지용 극판 미세홀 가공기(Battery Electrode Micro Hole Processing Equipment)로서 리튬이온 전지용 전극에 40마이크로미터(μm) 이하의 미세홀을 형성시킬 수 있고 금형과 제어장치를 갖춘 것으로 한정한다.
21	8479	89	기타	금속분말 흡입 거름 장비(Powder Conveyor Sieving Station)로서 금속분말을 흡입 후 외부에 새어나가지 않게 밀봉한 상태로 거를 수 있는 것으로 한정한다.
22	8479	89	기타	식각 시스템(Thinning System)으로서 기판 위에 도포된 솔더 레지스트(Solder Resist)를 전용약품을 통해 균일한 두께로 식각할 수 있는 것으로 한정한다.
23	8479	89	기타	5축 본딩시스템(Dispensing System)으로서 동시에 5축이 움직이면서 스캔을 진행하고 이를 기반으로 본드를 도포할 수 있는 것으로 한정한다.
24	8479	89	기타	안테나 방사 성능 분석용 장비로서 안테나 또는 무선 모듈에서 나오는 무선전파의 양을 조절하여 측정할 수 있는 것으로 한정한다.
25	8479	89	기타	자기필드챔버로서 직류(DC) 자장 또는 교류(AC) 자장을 650메가헤르츠(MHz) 이상 12기가헤르츠(GHz) 이하까지 제어할 수 있는 것으로 한정한다.
26	8479	89	기타	알칼리 이온수 생성장치로서 수소이온농도가 13.1피에이치(pH) 이상 13.2피에이치(pH) 이하인 알칼리 이온수 80리터(L)를 연속하여 생성하고 내부펌프를 사용하여 외부로 내보낼 수 있는 것으로 한정한다.
27	8479	89	기타	자동 열탈착기(Automated Thermal Desorber Pyrolyzer)로서 시료에서 휘발성 물질을 열탈착 방식으로 흡착튜브에 흡착 또는 포집한 후 기체 크로마토그래피(Gas Chromatography)에 주입시켜 분석할 수 있는 것으로 한정한다.
28	8479	89	기타	압출기로서 필름 제조 시 스크루(screw)의 회전속도가 0.2알피엠(rpm) 이상 120알피엠(rpm) 이하이며, 속도를 0.1알피엠(rpm) 단위로 조절할 수 있는 것으로 한정한다.
29	8479	89	기타	점토 가공기(Clay Milling Machine)로서 동시 5축 가공을 통해 자동차 모형을 제작하는 것으로 한정한다.
30	8479 8537	89 10	기타 전압이 1,000볼트 이하인것	가스분석기 통제 시스템(Exhaust Gas Analyzer Control System)로서 배기가스 규제 준수 여부를 확인하기 위해 컴퓨터 방식으로 가스분석기와 주변 장치를 제어하면서 데이터를 수집·연산하여 자동차의 배출가스와 연비를 측정하는 것으로 한정한다.

31	8485 8485	10 20	10 금속용 20 플라스틱·고무용	3차원프린터(3D Printer)로서 14마이크로미터(μm) 이하의 선으로 원하는 회로나 모양을 나타낼 수 있는 것으로 한정한다.
32	8514	19	기타	<p>노(爐, Furnace), 오븐, 열처리장치, 열압축가공기, 연속식 소성로 모의 실험장치로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 전기로(電氣爐)로서 최고 온도가 300도($^{\circ}\text{C}$) 이상이고 온도의 허용 오차 범위가 ± 8도($^{\circ}\text{C}$) 이하인 것 2. 열처리장치로서 자동차 피스톤링(Piston Ring)의 귀부(Tab)에 깊이 30마이크로미터(μm) 이상의 질화층을 형성할 수 있는 것 3. 한 변의 길이가 180밀리미터(mm) 이상이고 대각선의 길이가 240밀리미터(mm) 이상인 반도체웨이퍼를 열처리 및 확산(Diffusion)할 수 있으며, 면저항 균일도가 ± 10퍼센트(%) 이하인 것 4. 코터 오븐(Coater Oven)으로서 이차전지용 양극과 음극 황물질(Slurry), 첨가제를 가열 및 건조하여 양극재 또는 음극재의 최종 형태로 가공할 수 있는 것
33	8479 8543	89 30	기타 전기도금용·전기분해용 ·전기영동(泳動)용 기기	<p>코팅기(Coating Machine), 도금기(Plating system)로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 자동차 피스톤링(Piston Ring)에 다이아몬드-라이크카본(DLC, Diamond Like Carbon) 또는 4면체비정질탄소(TAC, Tetrahedral Amorphous Carbon)를 코팅할 수 있는 것 2. 로드(Rod)증발원을 탑재하고 아크 스팟(Arc Spot)의 위치 또는 막 두께의 분포를 자동으로 제어할 수 있는 것 3. 자동차 피스톤링이 고착(Sticking)되는 현상을 방지하기 위한 코팅을 하는 것
34	8543	70	그 밖의 기기	인터페이스 모듈로서 캔(CAN, Controller Area Network), 캔에프디(CANFD, Controller Area Network with Flexible Datarate), 린(LIN, Local Interconnect Network) 또는 플렉스 레이(Flex Ray) 신호를 유에스비(USB, Universal Serial Bus) 또는 이더넷(Ethernet) 방식을 통해 컴퓨터에 연결할 수 있는 것으로 한정한다.

35	8543	70	그 밖의 기기	<p>무선주파수 신호 수신기(EMI Test Receiver)로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 방송신호를 기록할 수 있는 것 2. 방송신호를 갈무리(Capture)한 기기로부터 기록된 신호를 공유하는 방법으로 신호를 재생할 수 있는 것
36	8543	70	그 밖의 기기	<p>무선 주파수 신호증폭기, 고주파 증폭기, 주파수변환기로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 20메가헤르츠(MHz)에서 40기가헤르츠(GHz)까지의 주파수 신호를 무선 주파수 케이블 또는 탐침(Probe)을 통해 입력받아 증폭시킬 수 있는 것 2. 계측기 규격에 맞게 측정 가능한 영역으로 주파수를 변환할 수 있는 것
37	8543	70	그 밖의 기기	<p>배터리 충전·방전 설비(Battery Testing System)로서 충전 시 정전류/정전압(CC/CV)과 방전 시 정전류(CC) 방식을 사용하는 이차전지 또는 연료전지의 충전시험이나 방전시험을 할 수 있는 것으로 한정한다.</p>
38	8543	70	그 밖의 기기	<p>분광타원해석기(Spectroscopic Ellipsometer)로서 기판에 193나노미터(nm) 이상 4,000나노미터(nm) 이하의 스펙트럼 범위의 빛을 비춰서 박막의 두께와 반사도(Reflective Index)를 분석하는 것으로 한정한다.</p>
39	8543	70	그 밖의 기기	<p>조도측정기(Surface Texture Measuring Instruments), 형상측정기(Contour Measuring Instruments)로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 코팅 또는 가공된 표면의 조도를 0.54나노미터(nm) 분해능 이하로 측정하여 그래프 또는 수치적으로 조도를 분석할 수 있는 것 2. 코팅 또는 가공된 표면, 소재면의 형상을 0.016나노미터(nm) 분해능까지 측정하여 그래프 또는 수치적으로 형상을 분석할 수 있는 것
40	8543	70	그 밖의 기기	<p>스위치 매트릭스로서 6개의 슬롯(Slot)이 있고 측정 대상 반도체소자의 연결상태를 스위치를 통해 바꿀 수 있는 것으로 한정한다.</p>
41	8543	70	그 밖의 기기	<p>신호변환기로서 오실레이터(Oscillator) 신호 생성기와 라디오 주파수(Radio Frequency) 신호 믹서를 포함하며, 2기가헤르츠(GHz) 이상 18기가헤르츠(GHz) 이하 대역의 자동 보정(Auto-calibration) 기능을 갖춘 것으로 한정한다.</p>

42	8543	70	그 밖의 기기	<p>단말 에뮬레이터(Emulator)로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 5G 무선 주파수를 이용하고, 5G의 통신 프로토콜(Protocol) 데이터를 생성하여 송수신이 가능한것 2. 휴대단말기 600대 이상의 통신프로토콜과 데이터신호를 구별하여 동시에 처리할 수 있는 것
43	8543	70	그 밖의 기기	<p>채널 에뮬레이터(Emulator)로서 다수의 무선 주파수 케이블을 통해 주파수 신호를 입력받고 그 신호를 변환 및 증폭하여 다시 다수의 무선 주파수 케이블로 출력할 수 있는 것으로 한정한다.</p>
44	9011	20	그 밖의 현미경(마이크로 사진용·마이크로 영화촬영용·마이크로 영사용으로 한정한다)	<p>현미경으로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 광학현미경(Optical Microscope) 또는 형광현미경(Fluorescent Microscope)으로서 영상을 촬영할 수 있고 컴퓨터와 연결하여 데이터를 전송할 수 있는 것 2. 시료의 표면 상태를 감지하고 분석할 수 있으며 영상처리할 수 있는 것 3. 3차원 측정을 구현할 수 있는 디지털 마이크로현미경
45	9029	10	적산(積算)회전계·생산량계·택시미터·주행거리계·보수계와 이와 유사한 계기	<p>자동차 피스톤링(Piston Ring)용 계수기(Counter)로서 방향 선별 기능을 가지고 있는 것으로 한정한다.</p>
46	9030	33	기타(기록장치가 없는 것으로 한정한다)	<p>저항계로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 반도체, 평판디스플레이 또는 이차전지 연구용으로서 웨이퍼박막, 글래스기판박막, 필름 또는 분체(粉體)의 저항을 측정할 수 있는 것 2. 시료에 전자빔을 비취서 전류를 증폭시키는 비접촉방식으로 저항을 분석할 수 있는 것